PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-060476

(43)Date of publication of application: 28.02.2003

(51)Int.CI.

HO3H 9/145 HO3H 3/10

H03H 9/64

(21)Application number: 2002-100164

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing:

02.04.2002

(72)Inventor: TAKAMINE YUICHI

(30)Priority

Priority number : 2001171414

Priority date: 06.06.2001

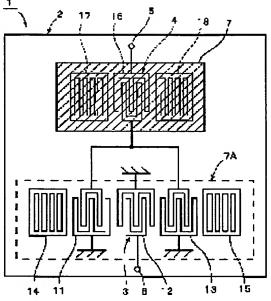
Priority country: JP

(54) SURFACE-ACOUSTIC WAVE DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a surface-acoustic wave device having a wide frequency band which has proper frequency—temperature characteristics, without causing impairment of the large deterioration of its intra-band insertion-loss or large reduction in its electromechanical coupling factor.

SOLUTION: On a piezoelectric substrate 2 of the surface-acoustic wave apparatus 1, there are formed one or more surface-acoustic wave filters 3 and one or more surface-acoustic wave resonators 4 connected in series/in parallel with the filters 3; further, there are formed films 7 having respectively positive frequency temperature characteristics, so as to cover at least one of the one or more surface-acoustic wave resonators 4, except for the regions where the surface-acoustic wave filters 3 are formed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.09.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-60476 (P2003-60476A)

(43)公開日 平成15年2月28日(2003.2.28)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
H03H	9/145		H03H	9/145	C 5J097
	3/10			3/10	
	9/64			9/64	Z

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 17 頁)

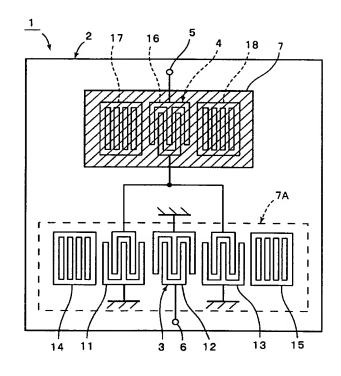
		Hamilton Manage Manage Con
(21)出願番号	特顏2002-100164(P2002-100164)	(71)出願人 000006231
		株式会社村田製作所
(22)出顧日	平成14年4月2日(2002.4.2)	京都府長岡京市天神二丁目26番10号
		(72)発明者 高峰 裕一
(31)優先権主張番号	特顧2001-171414(P2001-171414)	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式
(32)優先日	平成13年6月6日(2001.6.6)	会社村田製作所内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(74)代理人 100086597
		弁理士 宮▼崎▲ 主税
		Fターム(参考) 5J097 AA13 AA19 AA21 BB17 CC03
		CC04 DD29 GG03 HB04

(54) 【発明の名称】 弾性表面波装置

(57)【要約】

【課題】 帯域内挿入損失の大幅な劣化を招くことなく、電気機械結合係数の大幅な低下を招くことなく、良好な周波数温度特性を有し、広帯域の弾性表面波装置を提供する。

【解決手段】 圧電基板 2 上に少なくとも1 つの弾性表面波フィルタ3と、弾性表面波フィルタ3に直列及び/または並列に接続された少なくとも1 つの弾性表面波共振子4とが構成されており、弾性表面波フィルタ3が構成されている領域を除いて、少なくとも1 つの弾性表面波共振子のうち少なくとも1 つを覆うように正の周波数温度特性を有する膜7が形成されている、弾性表面波装置1。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 負の周波数温度特性を有する圧電基板 と、

1

前記圧電基板上に構成された少なくとも1つの弾性表面 波フィルタと、

前記圧電基板上に構成されており、前記弾性表面波フィ ルタに直列及び/または並列に接続された少なくとも1 つの一端子対弾性表面波共振子とを備え、

前記圧電基板上において、前記弾性表面波フィルタが構 成されている領域を除いて、少なくとも1つの前記弾性 10 表面波共振子のうち少なくとも1つを覆うように形成さ れた正の周波数温度特性を有する膜とを備える、弾性表 而波装置。

【請求項2】 前記弾性表面波フィルタに直列に接続さ れた前記一端子対弾性表面波共振子の少なくとも1つを 覆うように、前記正の周波数温度特性を有する膜が形成 されており、前記一端子対弾性表面波共振子の反共振周 波数が、前記弾性表面波フィルタの通過帯域高域側の減 衰域に存在するように構成されている、請求項1に記載 の弾性表面波装置。

【請求項3】 前記弾性表面波フィルタに並列に接続さ れた前記一端子対弾性表面波共振子の少なくとも1つを 覆うように前記正の周波数温度特性を有する膜が形成さ れており、前記一端子対弾性表面波共振子の共振周波数 が、前記弾性表面波フィルタの通過帯域低域側の減衰域 に存在するように構成されている、請求項1に記載の弾 性表面波装置。

【請求項4】 前記一端子対弾性表面波共振子のうち、 弾性表面波フィルタに直列に接続された少なくとも1つ の一端子対弾性表面波共振子を覆うように前記正の周波 30 数温度特性を有する膜が形成されており、該一端子対弾 性表面波共振子の反共振周波数が前記弾性表面波フィル タの通過帯域高域側の減衰域に存在するように構成され ており、前記弾性表面波フィルタに並列に接続された少 なくとも1つの一端子対弾性表面波共振子を覆うように 前記正の周波数温度特性を有する膜が形成されており、 該並列に接続された一端子対弾性表面波共振子の共振周 波数が前記弾性表面波フィルタの通過帯域低域側の減衰 域に存在するように構成されている、請求項1に記載の 弹性表面波装置。

【請求項5】 圧電基板と、

前記圧電基板上に構成された少なくとも1つの弾性表面 波フィルタと、

前記圧電基板上に構成されており、前記弾性表面波フィ ルタに直列及び/または並列に接続された少なくとも1 つの弾性表面波共振子とを備え、

前記圧電基板上において前記少なくとも1つの一端子対 弾性表面波共振子を覆うように形成された少なくとも1 つの第1の正の周波数温度特性を有する膜と、

前記圧電基板上において、前記弾性表面波フィルタを覆 50

うように形成された第2の正の周波数温度特性を有する

前記第2の正の周波数温度特性を有する膜の厚みが、第 1の正の周波数温度特性を有する膜の厚みよりも薄くさ れている、弾性表面波装置。

【請求項6】 前記弾性表面波フィルタに直列に接続さ れた前記一端子対弾性表面波共振子の少なくとも1つを 覆うように、前記第1の正の周波数温度特性を有する膜 が形成されていおり、前記一端子対弾性表面波共振子の 反共振周波数が、前記弾性表面波フィルタの通過帯域高 域側の減衰域に存在するように構成されている、請求項 5に記載の弾性表面波装置。

前記弾性表面波フィルタに並列に接続さ 【請求項7】 れた前記一端子対弾性表面波共振子の少なくとも1つを 覆うように前記第1の正の周波数温度特性を有する膜が 形成されており、前記一端子対弾性表面波共振子の共振 周波数が、前記弾性表面波フィルタの通過帯域低域側の 減衰域に存在するように構成されている、請求項5に記 載の弾性表面波装置。

【請求項8】 前記一端子対弾性表面波共振子のうち、 弾性表面波フィルタに直列に接続された少なくとも1つ の一端子対弾性表面波共振子を覆うように前記第1の正 の周波数温度特性を有する膜が形成されており、該一端 子対弾性表面波共振子の反共振周波数が前記弾性表面波 フィルタの通過帯域高域側の減衰域に存在するように構 成されており、前記弾性表面波フィルタに並列に接続さ れた一端子対弾性表面波共振子を覆うように前記第1の 正の周波数温度特性を有する膜が形成されており、該並 列に接続された一端子対弾性表面波共振子の共振周波数 が前記弾性表面波フィルタの通過帯域低域側の減衰域に 存在するように構成されている、請求項5に記載の弾性 表面波装置。

前記正の周波数温度特性を有する膜が、 【請求項9】 酸化ケイ素膜である、請求項1~8のいずれかに記載の 弹性表面波装置。

【請求項10】 前記酸化ケイ素膜が、SiO2膜であ る、請求項9に記載の弾性表面波装置。

【請求項11】 前記圧電基板が、36°~44°Yカ ットX伝搬LiTaO3基板からなる、請求項1~10 のいずれかに記載の弾性表面波装置。

請求項1~11のいずれかに記載の弾 【請求項12】 性表面波装置の周波数調整方法であって、前記正の周波 数温度特性を有する膜が形成されている一端子対弾性表 面波共振子のうち、少なくとも1つの一端子対弾性表面 波共振子において、正の周波数温度特性を有する膜をエ ッチングすることにより周波数調整を行うことを特徴と する、弾性表面波装置の周波数調整方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、弾性表面波フィル

40

タと弾性表面波共振子とが接続されている構造を有する 弾性表面波装置に関し、特に、圧電基板上に正の周波数 温度特性を有する膜が形成されている構造を備えた弾性 表面波装置及びその周波数調整方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、携帯電話システムでは、加入者の 増加及びサービスの多様化に伴って、送信帯域及び受信 帯域の幅が広く、かつ送信側周波数帯と受信側周波数帯 が近いシステムが増えてきている。これに伴って、通過 帯域幅が広く、かつ通過帯域ごく近傍の減衰量が大きい バンドパスフィルタが強く求められている。

【0003】携帯電話用RFフィルタとして、弾性表面 波フィルタが広く用いられている。この種の弾性表面波 フィルタでは、広帯域化を果たすために、電気機械結合 係数が大きい36°~44°YカットX伝搬のLiTa O3 基板が用いられている。しかしながら、36°~4 4°YカットX伝搬LiTaO3基板の周波数温度依存 性は、-30~-35ppm/℃と大きく、従って、こ の基板を用いた弾性表面波フィルタでは、温度変化に対 するマージンを多く確保しなければならなかった。その 20 ため、通過帯域ごく近傍の減衰量を大きくすることが困 難であった。

【0004】36°~44°YカットX伝搬LiTaO 3基板の周波数温度特性を補償する方法として、 A 1 電 極を基板上に形成した後、SiO2膜をさらに積層する 方法が提案されている(特開平2-37815号公 報)。ここでは、負の温度係数を有する36°~44° YカットX伝搬LiTaO3基板上に、正の温度係数を 有するSiO2膜を形成することにより、温度係数の絶 対値が小さくされている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、SiO 2膜を積層すると、弾性表面波フィルタの伝搬損失が大 きくなり、電気機械結合係数が小さくなるという問題が

【0006】例えば、36°YカットX伝搬LiTaO 3基板上に縦結合3 I D T 型共振子フィルタを構成した 場合の周波数特性が図16に示す通りとする。なお、図 中、「拡大スケールで示した特性」は、縦軸の右側で示 した拡大スケールにより示されている特性を示す。この 40 共振子フィルタ上に、SiO2膜を電極指ピッチによっ て定められる波長の15%の厚みとなるように積層した 場合の周波数特性は、図17に示すとおりとなる。

【0007】図16及び図17の比較から明らかなよう に、SiO2膜の形成による伝搬損失の悪化により、帯 域内挿入損失が大きく悪化すること、並びに電気機械結 合係数が小さくなることによりフィルタの通過帯域の中 央部が大きく窪んでいることがわかる。

【0008】上記のようなSiO2膜の形成による伝搬

り、携帯電話用RFフィルタとして用いられる周波数帯 では、使用不可能となる程に、帯域内挿入損失が悪化す る。

【0009】また、電気機械結合係数が小さくなるた め、フィルタの広帯域化が困難となり、従って、SiO 2膜の形成による周波数温度特性改善方法は、RFフィ ルタに起用するのは困難であった。

【0010】本発明の目的は、上述した従来技術の欠点 を解消し、正の周波数温度特性を有する膜の形成により 周波数温度特性を改善することができ、しかも帯域内挿 入損失の悪化を抑制することができ、かつ広帯域化を図 ることができる、弾性表面波装置を提供することにあ る。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明の広い局面によれ ば、圧電基板と、前記圧電基板上に構成された少なくと も1つの弾性表面波フィルタと、前記圧電基板上に構成 されており、前記弾性表面波フィルタに直列及び/また は並列に接続された少なくとも1つの一端子対弾性表面 波共振子とを備え、前記圧電基板上において、前記弾性 表面波フィルタが構成されている領域を除いて、少なく とも1つの前記弾性表面波共振子のうち少なくとも1つ を覆うように形成された正の周波数温度特性を有する膜 とを備える弾性表面波装置が提供される。

【0012】本発明の特定の局面では、前記弾性表面波 フィルタに直列に接続された前記一端子対弾性表面波共 振子の少なくとも1つを覆うように、前記正の周波数温 度特性を有する膜が形成されており、前記一端子対弾性 表面波共振子の反共振周波数が、前記弾性表面波フィル タの通過帯域高域側の減衰域に存在するように構成され 30 ている。

【0013】本発明の別の特定の局面では、前記弾性表 面波フィルタに並列に接続された前記一端子対弾性表面 波共振子の少なくとも1つを覆うように前記正の周波数 温度特性を有する膜が形成されており、前記一端子対弾 性表面波共振子の共振周波数が、前記弾性表面波フィル タの通過帯域低域側の減衰域に存在するように構成され ている。

【0014】本発明にかかる弾性表面波装置のさらに別 の特定の局面では、前記一端子対弾性表面波共振子のう ち、弾性表面波フィルタに直列に接続された少なくとも 1つの一端子対弾性表面波共振子を覆うように前記正の 周波数温度特性を有する膜が形成されており、該一端子 対弾性表面波共振子の反共振周波数が前記弾性表面波フ ィルタの通過帯域高域側の減衰域に存在するように構成 されており、前記弾性表面波フィルタに並列に接続され た少なくとも1つの一端子対弾性表面波共振子を覆うよ うに前記正の周波数温度特性を有する膜が形成されてお り、該並列に接続された一端子対弾性表面波共振子の共

減衰域に存在するように構成されている。

【0015】本発明の別の広い局面によれば、圧電基板 と、前記圧電基板上に構成された少なくとも1つの弾性 表面波フィルタと、前記圧電基板上に構成されており、 前記弾性表面波フィルタに直列及び/または並列に接続 された少なくとも1つの弾性表面波共振子とを備え、前 記圧電基板上において前記少なくとも1つの一端子対弾 性表面波共振子を覆うように形成された少なくとも1つ の第1の正の周波数温度特性を有する膜と、前記圧電基 板上において、前記弾性表面波フィルタを覆うように形 10 成された第2の正の周波数温度特性を有する膜とを備 え、前記第2の正の周波数温度特性を有する膜の厚み が、第1の正の周波数温度特性を有する膜の厚みよりも 薄くされている弾性表面波装置が提供される。

5

【0016】第2の発明の特定の局面では、前記弾性表 面波フィルタに直列に接続された前記一端子対弾性表面 波共振子の少なくとも1つを覆うように、前記第1の正 の周波数温度特性を有する膜が形成されていおり、前記 一端子対弾性表面波共振子の反共振周波数が、前記弾性 表面波フィルタの通過帯域高域側の減衰域に存在するよ うに構成されている。

【0017】第2の発明の別の特定の局面では、前記弾 性表面波フィルタに並列に接続された前記一端子対弾性 表面波共振子の少なくとも1つを覆うように前記第1の 正の周波数温度特性を有する膜が形成されており、前記 一端子対弾性表面波共振子の共振周波数が、前記弾性表 面波フィルタの通過帯域低域側の減衰域に存在するよう に構成されている。

【0018】第2の発明に係る弾性表面波装置のさらに 別の特定の局面では、前記一端子対弾性表面波共振子の うち、弾性表面波フィルタに直列に接続された少なくと も1つの一端子対弾性表面波共振子を覆うように前記第 1の正の周波数温度特性を有する膜が形成されており、 該一端子対弾性表面波共振子の反共振周波数が前記弾性 表面波フィルタの通過帯域高域側の減衰域に存在するよ うに構成されており、前記弾性表面波フィルタに並列に 接続された一端子対弾性表面波共振子を覆うように前記 第1の正の周波数温度特性を有する膜が形成されてお り、該並列に接続された一端子対弾性表面波共振子の共 振周波数が前記弾性表面波フィルタの通過帯域低域側の 減衰域に存在するように構成されている。

【0019】本発明(第1,第2の発明)では、好まし くは、上記正の周波数温度特性を有する膜として酸化ケ イ素膜または窒化ケイ素膜が用いられ、より好ましくは SiOz膜が用いられる。

【0020】本発明(第1,第2の発明)では、好まし くは圧電基板として36°~44°YカットX伝搬Li TaO3基板が用いられる。

【0021】本発明に係る弾性表面波装置の周波数調整 方法は、本発明に従って構成された弾性表面波装置の周 50 ィルタ3及び一端子対弾性表面波共振子4の構造及び下

波数調整にあたり、正の周波数温度特性を有する膜が形 成されている一端子対弾性表面波共振子のうち、少なく とも1つの一端子対弾性表面波共振子において、上記正 の周波数温度特性を有する膜をエッチングすることを特 徴とする。

[0022]

【発明の実施の形態】以下、本発明の具体的な実施例を 説明することにより、本発明を明らかにする。

【0023】図1は、本発明の第1の実施例に係る弾性 表面波装置の模式的平面図である。本実施例の弾性表面 波装置1では、36°YカットX伝搬LiTa〇3基板 からなる圧電基板2が用いられている。

【0024】圧電基板2上に、3IDT型の弾性表面波 フィルタ3と、一端子対弾性表面波共振子4とがA1電 極により形成されている。なお、Al電極の膜厚は、電 極指ピッチで定められる波長の8%とした。もっとも、 A1電極の膜厚は、周波数や必要帯域幅によって最適値 が異なる。

【0025】弾性表面波フィルタ3は、表面伝搬方向に 沿って配置された3個のIDT11~13と、IDT1 1~13が設けられている領域の両側に設けられた反射 器14,15とを有する。すなわち、弾性表面波フィル タ3は、縦結合の3IDT型弾性表面波共振子フィルタ である。もっとも、本実施例において、上記弾性表面波 フィルタ3は、この縦結合型3IDT型弾性表面波共振 子フィルタに限らず、他の構造のものであってもよい。 【0026】一端子対弾性表面波共振子4は、IDT1 6と、IDT16の両側に配置された反射器17,18 とを有する。もっとも、反射器17,18は設けられて 30 いなくともよい。

【0027】 IDT11, 13の一端が共通接続され、 一端子対弾性表面波共振子4のIDT16に接続されて いる。また、一端子対弾性表面波共振子4のIDT16 の他端が入力端子5に接続されている。IDT12の一 端が出力端子6に接続されている。IDT12の他端が アース電位に接続されている。また、IDT11,13 のIDT16に接続されている側とは反対側の端部はア ース電位に接続されている。

【0028】すなわち、一端子対弾性表面波共振子4 は、弾性表面波フィルタ3に直列に接続されている。一 端子対弾性表面波共振子4を覆うように、SiO2膜7 が形成されている。

【0029】すなわち、本実施例では、圧電基板2上に おいて、弾性表面波フィルタ3が設けられている領域を 除き、少なくとも一端子対弾性表面波共振子4が設けら れている領域を覆うようにSiO2膜7が形成されてい る。SiO2膜7の膜厚は、一端子対弾性表面波共振子 4の電極指ピッチによって定められる波長の15%とさ れているが、このSiO2膜7の膜厚は、弾性表面波フ

地のA1 電極膜の膜厚により、その最適値は異なる。 【0030】本実施例では、SiO2膜7の形成は、以下のようにして行われる。すなわち、圧電基板2上に、弾性表面波フィルタ3及び一端子対弾性表面波共振子4をA1電極膜により形成した後、スパッタリングにより全面にSiO2膜を形成する。このスパッタリングにはどのような装置を用いても良いが、ECRスパッタ装置を用いることが望ましい。しかる後、一端子対弾性表面波共振子4が設けられている領域をレジストで被覆し、レジストで被覆されている領域以外のSiO2膜をエッチングにより除去する。次に、上記レジストを除去す

【0031】SiO2膜7の形成方法は、上記方法に限定されず、CVDを用いた方法、またはエッチングにより不要なSiO2膜を除去する代わりにリフトオフプロセスにより除去する方法など、様々な方法を用いることができる。

【0032】また、一端子対弾性表面波共振子4上のSiO2膜7を必要分だけドライエッチングにより除去することにより、一端子対弾性表面波共振子4の周波数調 20整を行うことができる。この周波数調整において行われるエッチングプロセスは、ウェットエッチングであってもよい。上記のような周波数調整を行うことにより、弾性表面波装置1の不良率を大幅に低減することができる

【0033】上記実施例に従って、構成された弾性表面 波装置1の効果を確認するために、SiO2膜7が形成 されていないことを除いては、上記実施例と同様に構成 された図2に示す比較例の弾性表面波装置1Aを用意した。そして、弾性表面波装置1,1Aの周波数特性を測 30 定した。なお、弾性表面波フィルタ3及び一端子対弾性表面波共振子4の仕様は以下のとおりとした。

【0034】弾性表面波フィルタ3…IDT11~13の電極指ピッチ:1.02μm、IDT11~13の電極指の対数13.5/20.5/13.5対、反射器14,15の電極指の本数=100本、一端子対弾性表面波共振子4のIDT16の電極指ピッチ=0.96μm、電極指の対数=150対、反射器17,18の電極指の本数=30本

【0035】図3及び図4から明らかなように、第1の実施例の弾性表面波装置1の周波数特性では、比較例1の弾性表面波装置1Aに比べて、通過帯域高域側(2010~2030MHz付近)の減衰量及び帯域内挿入損失が若干悪化している。これは、SiO2膜7の形成により、一端子対弾性表面波共振子4の伝搬損失が大きくなったためである。

【0036】しかしながら、この帯域内挿入損失の悪化は、RFフィルタとして使用不可能な程度まで大きいものではない。また、弾性表面波装置1における通過帯域高域側ごく近傍の急峻性は、弾性表面波装置1Aにおけ 50

る急峻性とほぼ同等である。

【0037】次に、弾性表面波装置1, 1Aについて、 温度を-25C \sim +75Cの範囲で変化させた場合の周 波数特性の変化を測定した。結果を図5及び図6に示す。

【0038】図5に示す弾性表面波装置1の周波数特性 では、図6に示す弾性表面波装置1Aの周波数特性に比 べて、通過帯域ごく近傍の周波数においては、温度に対 する変化が小さくなっていることがわかる。この変化を 温度係数で比較すると、通過帯域高域側において、スル ーレベル(0 d B)から5 d Bの減衰量の位置における 温度係数は、弾性表面波装置1Aでは-35.1ppm /℃であるのに対し、実施例の弾性表面波装置1では-23.8ppm/℃まで改善されていることがわかる。 なお、本明細書において、温度係数とは、温度に対する 周波数の変化量をppmで表わしたものであり、ppm で表現しているのは、周波数が変わるとピッチが変わる ため、温度に対する変化の度合いが変化するからであ る。上記スルーレベルから減衰量が5 d B である周波数 を各温度で求め、このデータを直線近似することによ り、温度に対する周波数変化の係数が求められる。この 温度に対する周波数変化の係数を、フィルタの中心周波 数(1960MHz)で割ることにより、温度係数(p pm) が求められる。

【0039】上記から、実施例の弾性表面波装置1によれば、通過帯域ごく近傍に存在する減衰域における周波数変化を、使用温度範囲を-25 \mathbb{C} \sim +75 \mathbb{C} \mathbb{C} \sim とした場合、約1.1 \mathbb{M} \mathbb{M} \mathbb{C} \sim 0

【0040】上記温度特性が改善される効果をより明瞭に説明するために、弾性表面波装置1における弾性表面波フィルタ3及び一端子対弾性表面波共振子4、並びに弾性表面波装置1Aにおける一端子対弾性表面波共振子を、それぞれ単体で-25℃~+75℃まで温度を変化させた場合の周波数特性を図7~図9に示す。なお、弾性表面波フィルタ1Aにおける弾性表面波共振子では、前述したようにSiO2膜7が積層されていない。

【0041】図7~9から明らかなように、弾性表面波フィルタ3の通過帯域高域側の減衰域の周波数と、一端子対弾性表面波共振子4の反共振周波数がほぼ一致していることがわかる。これにより、弾性表面波装置1では、通過帯域高域側ごく近傍の周波数温度特性は、弾性表面波フィルタ3に一端子対弾性表面波共振子4が直列に接続されると、周波数温度特性は両者の中間的な周波数温度特性となる。すなわち、上記実施例のように、弾性表面波フィルタ3の通過帯域高域側の減衰域に、一端子対弾性表面波共振子の反共振周波数を設定することにより、一端子対弾性表面波共振子の周波数温度特性が改善され、通過帯域高域側における周波数温度特性が改善され、通過帯域高域側における周波数温度特性が改善される。

【0042】図8と図9とを比較すれば、図8に示した

特性の弾性表面波共振子の方が、図9に示した特性の弾 性表面波共振子よりも温度に対する周波数変化が小さく なっている。従って、図8に示した特性の弾性表面波共 振子あるいは図9に示した特性の弾性表面波共振子を図 7に示した弾性表面波フィルタに直列に接続した場合、 通過帯域高周波側における温度に対する周波数変化は、 図8に示した特性の弾性表面波共振子を使った場合の方 が小さくなる。

【0043】この場合、弾性表面波フィルタ3にはSi O2膜が形成されていないので、伝搬損失が大きく悪化 せず、かつ電気機械結合係数が小さくなることはない。 すなわち、弾性表面波フィルタ3に直列に接続された一 端子対弾性表面波共振子においてSiО2膜が形成され ている場合の該一端子対弾性表面波共振子の反共振周波 数を、弾性表面波フィルタ3の通過帯域高域側の減衰域 に存在させることにより、帯域内挿入損失の大きな劣化 を抑制し、通過帯域高域側において良好な周波数温度特 性を有する、広帯域の弾性表面波装置1を構成すること ができる。

【0044】図10は、本発明の第2の実施例に係る弾 性表面波装置21の模式的平面図である。第2の実施例 の弾性表面波装置21では、36°YカットX伝搬Li TaO3基板22上に、A1電極により、弾性表面波フ ィルタ23及び一端子対弾性表面波共振子24が形成さ れている。A1電極の膜厚は、電極指ピッチにより定め られる波長の8%とした。

【0045】弾性表面波フィルタ23では、表面波伝搬 方向に沿って3個のIDT31~33が配置されてい る。また、IDT31~33が設けられている領域の両 側に反射器34,35が配置されている。すなわち、弾 性表面波フィルタ33は、縦結合型の3IDT型弾性表 面波共振子フィルタである。

【0046】一端子対弾性表面波共振子24では、ID T36の両側に反射器37,38が配置されている。一 端子対弾性表面波共振子24を覆うようにSiO2膜2 7が形成されている。

【0047】SiO2膜27の膜厚は、電極指ピッチに よって定められる波長の15%とされている。このSi O2膜の形成方法は第1の実施例と同様である。

【0048】本実施例では、上記弾性表面波フィルタ2 3のIDT31,33の一端が共通接続され、入力端子 25に接続されている。また、IDT31,33の他端 はアース電位に接続される。IDT32の一端が出力端 子26に接続されており、他端がアース電位に接続され ている。そして、一端子対弾性表面波共振子24のID T36の一端が入力端子25に、他端がアース電位に接 続されている。従って、一端子対弾性表面波共振子24 は、弾性表面波フィルタ23に並列に接続されている。

【0049】第2の実施例の弾性表面波装置21の効果 を明らかにするために、比較例2として、図11に模式 50 4, 45は、A1電極により構成されており、このAl

的に示す弾性表面波装置21Aを用意した。この弾性表 面波装置21Aは、一端子対弾性表面波共振子24を覆 うようにSiO2膜27が形成されていないことを除い ては、弾性表面波装置21と同様に構成されている。

【0050】なお、弾性表面波フィルタ23及び一端子 対弾性表面波共振子24の仕様は第1の実施例の弾性表 面波フィルタ3及び一端子対弾性表面波共振子4と同様 とした。

【0051】図12及び図13は、弾性表面波装置2 10 1,21 Aを、-25℃~+75℃の範囲で温度変化さ せた場合の周波数特性の変化をそれぞれ示す。図12及 び図13から明らかなように、第2の実施例の弾性表面 波装置21の周波数特性では、通過帯域低域側ごく近傍 の温度に対する変化が、比較例2の弾性表面波装置21 Aの周波数特性の場合に比べて小さくなっていることが わかる。これを温度係数で比較すると、比較例2の弾性 表面波装置21Aでは、通過帯域高域側において、スル ーレベル (0 d B) から減衰量が 5 d Bの位置における 温度係数は-35.7ppm/℃であるのに対し、第2 の実施例の弾性表面波装置21Aでは-25.6ppm /℃まで改善されている。

【0052】従って、第2の実施例では、通過帯域高域 側ごく近傍にある減衰域Aにおける周波数変化を、使用 温度範囲を-25℃~+75℃とした場合、約1.0M Hz小さくすることができる。

【0053】上記効果は、SiO2膜が積層されている 一端子対弾性表面波共振子24が弾性表面波フィルタ2 3に並列に接続されており、一端子対弾性表面波共振子 24の共振周波数が、通過帯域低域側の減衰域に存在す るように構成されていることにより、弾性表面波装置2 1の通過帯域低域側の周波数温度特性は、弾性表面波フ ィルタ23の周波数温度特性と一端子対弾性表面波共振 子24の周波数温度特性の中間的な周波数温度特性とな っていることによる。すなわち、弾性表面波フィルタ2 3に並列に接続されており、かつSiO2膜が積層され ている一端子対弾性表面波共振子24の共振周波数を、 弾性表面波フィルタ23の通過帯域低域側の減衰域に存 在させることにより、帯域内挿入損失の大幅な劣化を招 くことなく、通過帯域低域側において良好な周波数温度 特性を有する、広帯域の弾性表面波装置21を提供する ことができる。

【0054】図14は、本発明の第3の実施例に係る弾 性表面波装置の略図的平面図である。弾性表面波フィル タ装置41では、36°YカットX伝搬LiTaO3基 板からなる圧電基板(図示せず)上に、弾性表面波フィ ルタ43と、弾性表面波フィルタ43に直列に接続され た一端子対弾性表面波共振子44と、並列に接続された 一端子対弾性表面波共振子45とが形成されている。弾 性表面波フィルタ43、一端子対弾性表面波共振子4

ことができる。

電極の膜厚は、電極指ピッチにより決められる波長の8%とされている。

【0055】また、一端子対弾性表面波共摂子44, 45を覆うように、SiO2 膜48, 48 Aが形成されている。弾性表面波フィルタ43 上にはSiO2 膜は形成されていない。

【0056】従って、弾性表面波装置41は、第1,第2の実施例の弾性表面波装置1,11を組み合わせた構造に相当する。弾性表面波フィルタ43は、弾性表面波フィルタ3,13と同様に構成されている。また、弾性表面波共振子44は、第1の実施例で用いた弾性表面波共振子4と同様に構成されており、弾性表面波共振子45は、第2の実施例で用いられた弾性表面波共振子14と同様に構成されている。

【0057】なお、図16において、46は入力端子を、47は出力端子を示す。本実施例においては、SiO2膜48,48Aの膜厚は、電極指ピッチにより定められる波長の15%とした。なお、SiO2膜の形成方法は第1の実施例と同様にである。

【0058】本実施例の弾性表面波装置41を、-25 ℃~+75℃の範囲で温度変化させた場合の周波数特性 の変化を図15に示す。なお、弾性表面波フィルタ4 3、弾性表面波共振子44,45は、第1,第2の実施 例と同様に構成した。

【0059】図15から明らかなように、第3の実施例の周波数特性では、通過帯域低域側及び高域側ごく近傍の周波数において温度に対する変化が小さくなっていることがわかる。温度係数で評価すると、通過帯域低域側において、スルーレベル(0dB)から減衰量が5dBである周波数における温度係数は-25.3ppm/℃、通過帯域高域側においてスルーレベルから減衰量が5dBである周波数における温度係数は-25.7ppm/℃である。従って、第1,第2の実施例において、比較のために用意した比較例1,2の弾性表面波装置に比べて、本実施例では、通過帯域全体において周波数温度特性が改善され得ることがわかる。

【0060】第3の実施例では、第1,第2の実施例を組み合わせた構造とされているので、弾性表面波フィルタ33に直列に接続されている一端子対弾性表面波共振子34の反共振周波数が、通過帯域高域側の減衰域に存在するように構成されており、並列に接続されている一端子対弾性表面波共振子45の共振周波数が、通過帯域低域側の減衰域に存在するように構成されているので、第1,第2の実施例の双方の効果を得ることができる。従って、通過帯域内における挿入損失の大幅な劣化を招くことなく、通過帯域内全体において、良好な周波数温度特性を有し、広帯域の弾性表面波装置41を提供することができる。

【0061】なお、第1~第3の実施例においては、弾性表面波フィルタ3,23,43上にはSiO2膜が形

成されていないが、例えば、図3において破線で模式的 に示すように、弾性表面波フィルタ3を覆うように第2 のSiO2膜7Aを形成してもよい。この場合、一端子 対弾性表面波共振子4を覆うSiOz膜を第1のSiOz 膜とすると、第2のSiOz膜7Aの厚みは、第1のS iO2膜7の厚みより薄くされていればよい。すなわ ち、例えば金属粉が付着するのを防止するのに、保護膜 として、弾性表面波フィルタ3を覆うように第2のSi O2膜7Aを形成してもよく、その場合には、第2のS iO2膜7Aの厚みを第1のSiO2膜7よりも薄くして おけばよく、すなわち弾性表面波フィルタ3の特性が劣 化しない程度の薄いSiO2膜7Aを形成してもよい。 このような厚みの薄い第2のSiO2膜7Aを形成した 場合であっても、第1の実施例と同様に、第1のSiO 2膜7の形成により、第1の実施例と同様に帯域内挿入 損失の大きな劣化を招くことなく、周波数温度特性を改 善することができる。同様に、第2,第3の実施例にお いても、弾性表面波フィルタ23, 43を覆うように弾 性表面波共振子を覆う第1のSiO2膜よりも厚みが薄 く、特性が劣化しない程度の第2のSiO2膜を形成し てもよく、第2, 第3の実施例と同様に帯域内挿入損失 の大きな劣化を招くことなく周波数温度特性を改善する

12

【0062】なお、第1の実施例では、弾性表面波フィルタ3に直列に1個の弾性表面波共振子4が接続されており、第2の実施例では、弾性表面波フィルタ23に並列に1個の弾性表面波共振子24が接続されていたが、それぞれ、複数の一端子対弾性表面波共振子が接続されていてもよい。その場合、複数の弾性表面波共振子のうち少なくとも1つの弾性表面波共振子を覆うようにSiO2膜が形成されていれば、第1,第2の実施例と同様に、周波数温度特性を改善することができる。

【0063】また、第3の実施例では、弾性表面波フィルタ43に1個の弾性表面波共振子44が直列に、1個の弾性表面波共振子45が並列に接続されていたが、直列に接続される弾性表面波共振子が複数であってもよく、並列に接続される弾性表面波共振子が複数であってもよい。この場合においても、少なくとも1つの弾性表面波共振子において、SiOz膜が形成されていれば、第1の実施例または第2の実施例と同様に周波数温度特性を改善することができ、好ましくは、直列に接続される弾性表面波共振子の双方に、第3の実施例のようにSiOz膜が形成され、それによって通過帯域の広い範囲に渡り周波数温度特性を改善することができる。

【0064】第1の実施例において説明したように、本 発明に係る弾性表面波装置では、上記のようにして一端 子対弾性表面波共振子を覆うように形成されている正の 50 周波数温度特性を有する膜を、少なくとも1つの弾性表

面波共振子においてエッチングすることにより、周波数 調整を行うことができ、それによって所望とする受信周 波数の弾性表面波装置を容易に提供することができる。

13

【0065】なお、上記実施例では、正の周波数温度特 性を有する膜として、SiO2膜が用いられていたが、 SiO2膜以外の酸化ケイ素膜を用いてもよく、また窒 化ケイ素膜などの他の正の周波数温度特性を有する膜を 用いてもよい。

【0066】なお、上記実施例では、圧電基板として、 36°YカットX伝搬のLiTaO3基板を用いたが、 本発明では、これに限らず、36°~44°YカットX 伝搬のLiTaO3基板、すなわち、負の温度係数を有 する上記圧電基板を用いた弾性表面波装置に好適に用い ることができる。

【0067】また、本発明において、圧電基板上に構成 される弾性表面波フィルタは複数であってもよい。

[0068]

【発明の効果】第1の発明に係る弾性表面波装置では、 少なくとも1つの弾性表面波フィルタに直列及び/また は並列に少なくとも1つの弾性表面波共振子が接続され 20 ており、弾性表面波フィルタが構成されている領域を除 いて、少なくとも1つの弾性表面波共振子のうち少なく とも1つを覆うように正の周波数温度特性を有する膜が 形成されている。SiO2膜は正の温度係数を有し、従 って、圧電基板として、負の温度係数を有するものが用 いられているが、弾性表面波装置の通過帯域の高域側ま たは低域側ごく近傍の周波数温度特性が、弾性表面波フ ィルタ及び直列または並列に接続された一端子対弾性表 面波共振子の周波数温度特性の中間的な周波数温度特性 となるとなるため、弾性表面波装置全体としての周波数 温度特性が改善される。しかも、弾性表面波フィルタ自 体には、正の周波数温度特性を有する膜が形成されてい ないので、伝搬損失の大幅な劣化や電気機械結合係数の 低下を招くことがない。

【0069】すなわち、従来、温度特性を改善するため に弾性表面波フィルタにおいては全面にSiO2膜が設 けられていたが、この場合には、電気機械結合係数が小 さくなるという問題があった。これに対して、第1の発 明では、一端子対弾性表面波共振子を弾性表面波フィル タに接続することにより十分な減衰量が得られる。しか 40 も、弾性表面波共振子にのみ一定の周波数温度特性を有 する膜を形成することにより、温度特性が改善されてい る。すなわち、フィルタ特性を維持しつつ、温度特性が 改善される。従って、帯域内挿入損失の劣化を招くこと なく、良好な周波数温度特性を有する広帯域の弾性表面 波装置を提供することができる。

【0070】第1の発明の第1の特定の局面では、弾性 表面波フィルタに直列に接続された一端子対弾性表面波 共振子の少なくとも1つを覆うように、上記SiO2膜 が形成されており、一端子対弾性表面波共振子の反共振 50 共振子の少なくとも1つを覆うように、上記第1のSi

周波数が弾性表面波フィルタの通過帯域高域側の減衰域 に存在するように構成されている。従って、通過帯域高 域側における周波数温度特性が改善され、すなわち大き な通過帯域内挿入損失の劣化を招くことなく、通過帯域 高域側において良好な周波数温度特性を有する、広帯域 の弾性表面波装置を提供することができる。

14

【0071】第1の発明の第2の特性の局面では、弾性 表面波フィルタに並列に接続された一端子対弾性表面波 共振子のうち少なくとも1つを覆うように正の周波数温 度特性を有する膜が形成されており、一端子対弾性表面 波共振子の共振周波数が、弾性表面波フィルタの通過帯 域低域側の減衰域に存在するように構成されているの で、通過帯域低域側における周波数温度特性を改善する ことができ、大幅な帯域内挿入損失の劣化を招くことな く、通過帯域低域側において良好な周波数温度特性を有 する、広帯域の弾性表面波装置を提供することがてき

【0072】第1の発明において、上記第1,第2の特 定の局面で提供される構成を組み合わせた場合には、通 過帯域の高域側及び低域側の双方において周波数温度特 性を改善することができ、それによって大幅な帯域内挿 入損失の劣化を招くことなく、通過帯域の全域に渡り良 好な周波数温度特性を有し、広帯域の弾性表面波装置を 提供することができる。

【0073】第2の発明に係る弾性表面波装置では、圧 電基板上に少なくとも1つの弾性表面波フィルタが構成 されており、該弾性表面波フィルタに直列及び/または 並列に少なくとも1つの弾性表面波共振子が接続されて いる構成において、少なくとも1つの弾性表面波共振子 を覆うように少なくとも1つの第1の正の周波数温度特 性を有する膜が形成されており、弾性表面波フィルタを 覆うように第2の正の周波数温度特性を有する膜が形成 されており、第2の正の周波数温度特性を有する膜の厚 みが第1の正の周波数温度特性を有する膜の厚みよりも 薄くされているので、すなわち、第2の発明において も、第1の正の周波数温度特性を有する膜が少なくとも 1 つの弾性表面波共振子を被覆しているので、弾性表面 波共振子の負荷により十分な減衰量が得られ、かつ該第 1の正の周波数温度特性を有する膜により温度特性が改 善される。上記第1の正の周波数温度特性を有する膜が 形成されているため、大幅な帯域内挿入損失の劣化を招 くことなく、通過帯域の低域側または高域側において良 好な周波数温度特性を実現することができ、広帯域の弾 性表面波装置を提供することができる。また、この場 合、第2の正の周波数温度特性を有する膜により弾性表 面波フィルタが覆われているので、金属粉などに対して 弾性表面波フィルタを保護することができる。

【0074】第2の発明の第1の特定の局面では、弾性 表面波フィルタに直列に接続された一端子対弾性表面波 O2 膜が形成されており、一端子対弾性表面波共振子の 反共振周波数が弾性表面波フィルタの通過帯域高域側の 減衰域に存在するように構成されているので、通過帯域 高域側における周波数温度特性が改善され、すなわち大 きな通過帯域内挿入損失の劣化を招くことなく、通過帯 域高域側において良好な周波数温度特性を有する、広帯 域の弾性表面波装置を提供することができる。

【0075】第2の発明の第2の特性の局面では、弾性表面波フィルタに並列に接続された一端子対弾性表面波共振子のうち少なくとも1つを覆うように第1のSiO2膜が形成されており、一端子対弾性表面波共振子の共振周波数が、弾性表面波フィルタの通過帯域低域側の波衰域に存在するように構成されているので、通過帯域低域側における周波数温度特性を改善することができ、大幅な帯域内挿入損失の劣化を招くことなく、通過帯域低域側において良好な周波数温度特性を有する、広帯域の弾性表面波装置を提供することができる。

【0076】第2の発明において、上記第1,第2の特定の局面で提供される構成を組み合わせた場合には、通過帯域の高域側及び低域側の双方において周波数温度特 20性を改善することができ、それによって大幅な帯域内挿入損失の劣化を招くことなく、通過帯域の全域に渡り良好な周波数温度特性を有し、広帯域の弾性表面波装置を提供することができる。

【0077】本発明において、上記圧電基板として、36°~44°YカットX伝搬LiTaO3基板を用いた場合、36°~44°YカットX伝搬LiTaO3基板が負の抵抗温度特性を有するが、上記正の周波数温度特性を有する膜の形成により、周波数温度特性を改善し得るので、本発明に従って、周波数温度特性が良好な広帯 30域の弾性表面波装置を提供することができる。

【0078】本発明に係る周波数調整方法では、上記正の周波数温度特性を有する膜が形成されている一端子対弾性表面波共振子のうち少なくとも1つの弾性表面波共振子において、SiO2膜をエッチングするだけで、容易に周波数を調整することができ、所望とする帯域の弾性表面波装置を容易に提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例に係る弾性表面波装置の 模式的平面図。

【図2】比較のために用意した弾性表面波装置を示し、 SiO2膜が一端子対弾性表面波共振子を覆うように形 成されていない弾性表面波装置の模式的平面図。

【図3】第1の実施例の弾性表面波装置の周波数特性を 示す図。

【図4】比較例1の弾性表面波装置の周波数特性を示す図。

【図5】第1の実施例において、温度を-25℃~+75℃の範囲で変化させた場合の周波数特性の変化を示す図。

【図6】比較例1の弾性表面波装置において、温度を-25℃~+75℃の範囲で変化させた場合の周波数特性

16

の変化を示す図。

【図7】第1の実施例で用いられている弾性表面波フィルタ単体において、温度が-25 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ +75 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 定化された場合の周波数特性の変化を示す図。

【図8】第1の実施例で用いられている一端子対弾性表面波共振子単体において、温度が-25 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 1、で変化された場合の周波数特性の変化を示す図。

10 【図9】比較例1の弾性表面波装置に用いられている一端子対弾性表面波共振子単体において、温度が-25℃ ~+75℃まで変化された場合の周波数特性の変化を示す図。

【図10】第2の実施例の弾性表面波装置の回路構成を 説明するための模式的平面図。

【図11】比較例2の弾性表面波装置を説明するための図であり、SiO2膜が一端子対弾性表面波共振子を覆うように形成されていない弾性表面波装置の模式的平面図。

20 【図12】第2の実施例において、温度が-25℃~+75℃まで変化された場合の周波数特性の変化を示す図。

【図13】比較例2において、温度が-25℃-25℃-175℃まで変化された場合の周波数特性の変化を示す図。

【図14】本発明の第3の実施例に係る弾性表面波装置 を説明するための模式的平面図。

【図15】本発明の第3の実施例に係る弾性表面波装置において、温度が-25 \mathbb{C} -+75 \mathbb{C} まで変化された場合の周波数特性の変化を示す図。

【図16】従来例の周波数特性を示す図であり、36° YカットX伝搬LiTaO3基板上に縦結合型3IDT 型の共振子フィルタが構成されている場合の周波数特性 を示す図。

【図17】図1に示した弾性表面波フィルタにおいて、電極指ピッチで定められる波長の15%の厚みSiO2膜を積層した場合の周波数特性を示す図。

【符号の説明】

- 1…弾性表面波装置
- 2…圧電基板
- 40 3…弾性表面波フィルタ
 - 4…一端子対弾性表面波共振子
 - 5…入力端子
 - 6…出力端子
 - 7…SiO2膜 (第1のSiO2膜)
 - 7 A…第2のS i O2膜
 - 21…弾性表面波装置
 - 22…圧電基板
 - 23…弾性表面波フィルタ
 - 2 4 …一端子対弾性表面波共振子
- 50 25…入力端子

-9-

(10)

特開2003-60476

18

26…出力端子

41…弹性表面波装置

43…弾性表面波フィルタ

4 4 …一端子对弹性表面波共振子

45…一端子対弾性表面波共振子

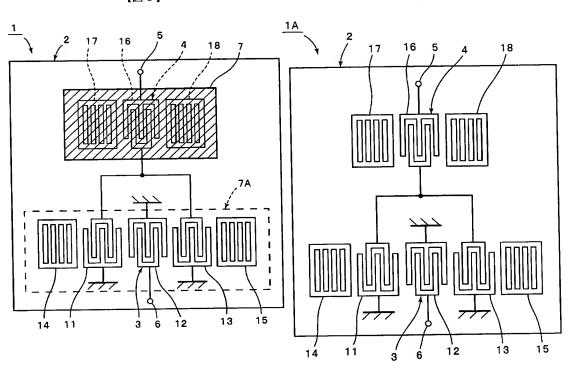
47…出力端子 48, 48A…SiO2膜

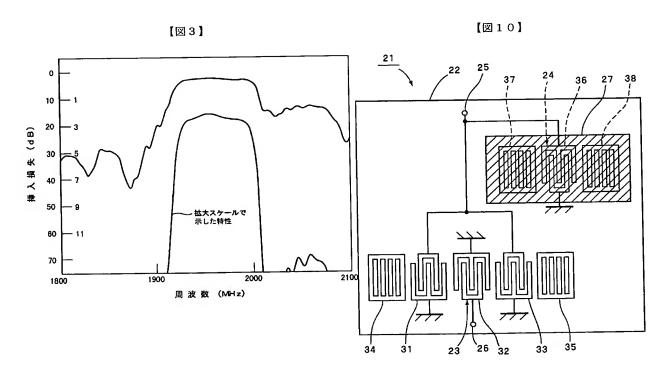
46…入力端子

【図1】

17

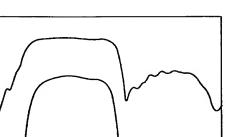
【図2】

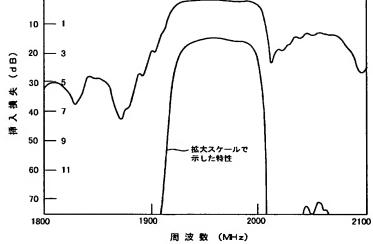


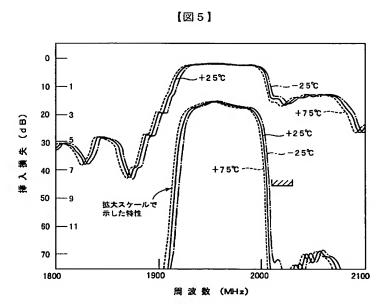


[図4]

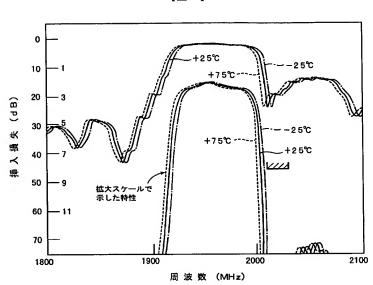
0



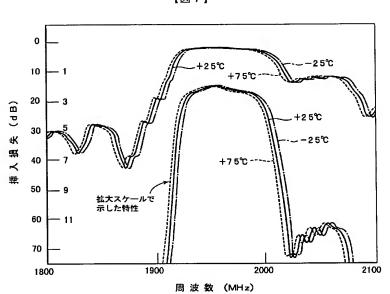




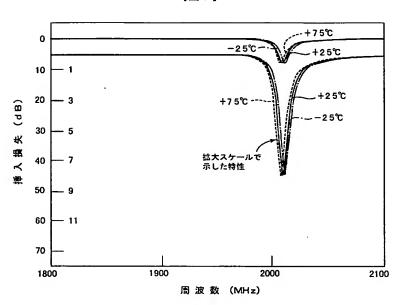




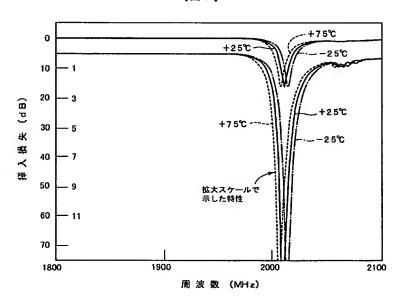
[図7]



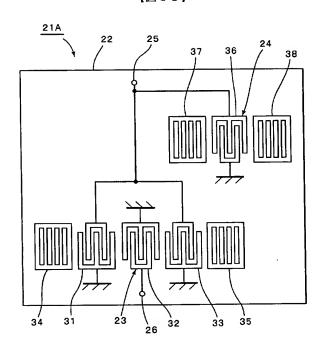




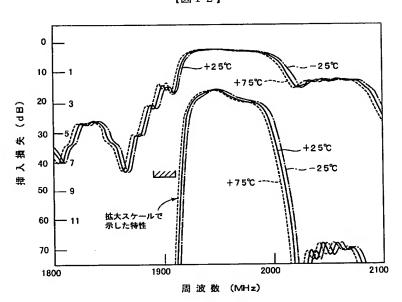
【図9】



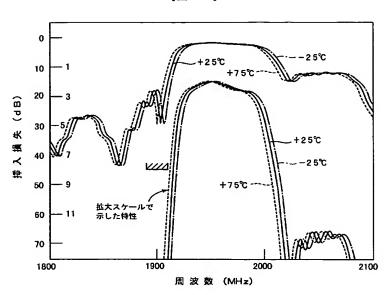
【図11】



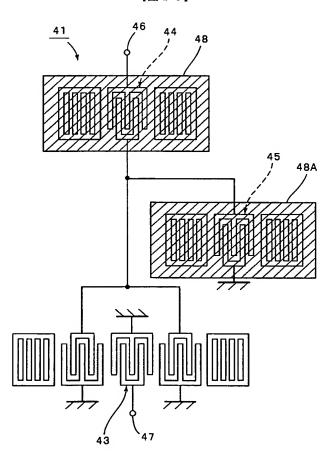
【図12】



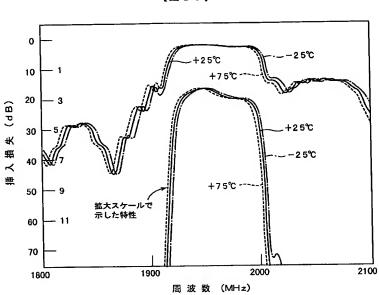




【図14】



【図15】



【図16】

